

浙江省电子信息情报网

网 讯

第 241 期

2019-12-2

浙江省半导体行业协会主办

省内资讯

绍兴集成电路产业小镇一组新闻

杭州寰星电子发布 Wi-Fi、蓝牙、SSD 三款芯片新品

第 94 届中国电子展开幕 省半导体协会率团观展

协会成功推荐江丰电子姚立军董事长入选第十八届优秀企业家

协会成功推荐晶盛机电产品入选“2019 年浙江省优秀工业产品”

中晶嘉兴年产 480 万片 12 英寸大硅片项目进展顺利

宁波再添芯动力:康强电子半导体封装材料等三大 IC 项目同日落地

“中欣晶圆大硅片项目”竣工投产

博雅鸿图发布首颗数字视网膜系列芯片“鸿芯图腾 GV9531”

国内资讯

晶圆代工双雄争霸汽车市场

总投资 15 亿元，氮化镓半导体材料项目落户辽宁盘锦

华通投资 25 亿建全球领先手机电路板工厂

上达电子柔性集成电路封装基板项目在安徽六安开工

国际资讯

三星正式发布 Exynos 990 旗舰处理器

美开发出新型可拉伸、可降解半导体材料

钙钛矿 LED 发光效率提高 4 倍

业内看点:

严晓浪:集成电路产业未来 5 年或将带动超千亿元整机产值

宁波集成电路产业如何突围? 丁勇如是说

格芯:摩尔定律不会死去,但是意义已经发生变化

省内资讯

1. 绍兴集成电路产业小镇一组新闻

(1) 2019 中国（绍兴）第二届集成电路产业峰会近期举行

2019年11月15-16日，以“新机遇、新融合、新发展”为主题的2019中国（绍兴）第二届集成电路产业峰会举行。本次峰会为绍兴赋予芯动能，也是一场我国集成电路行业的盛会。此次峰会吸引了300+IC专家学者以及行业代表，交流探讨新时期下集成电路产业的机遇与挑战，把脉未来市场热点与应用，共商绍兴集成电路产业发展大计。中国工程院院士邱爱慈女士、国家发改委、工信部、绍兴市委书记马伟光均在高峰会上致辞。



中国工程院院士邱爱慈女士在峰会上致辞



浙江省副省长高兴夫在峰会上致辞中指出，集成电路是浙江省重点培育发展的产业，随着中芯国际绍兴项目，长电绍兴项目等顺利落地开展，绍兴将能够实现产业规模的快速扩张，产业创新能力的快速提升。



2019 中国（绍兴）第二届集成电路产业峰会



绍兴市委书记马卫光在峰会上致辞。

(2) 绍兴集成电路创新综合体项目正式启动

11月15日上午，绍兴集成电路创新综合体项目举行开工仪式。绍兴市委书记马卫光宣布项目开工。市委副书记、市长盛阅春讲话。中芯国际集成电路制造有限公司 CFO 高永岗致辞。市领导谭志桂、陆维、邵全卯、黄文泽等参加。绍兴集成电路创新综合体项目是绍兴集成电路产业园作为浙江省“万亩千亿”新产业平台的标志性项目和首发项目。总投资 50 亿元，占地面积 188 亩，项目由 A、B、C 三个地块组成。目前，综合体已招引落户：惠诺电子材料、埃鼎智能、尧芯科技、伟芯科技（绍兴）、费米科技、高笙半导体、最成半导体等 10 余家集成电路企业，已引进海外 330 人才、越州英才等集成电路专业人才超百名。

(3) 中芯国际绍兴 8 英寸产线顺利投产

11 月 25 日，位于越城区皋埠街道的中芯集成电路制造(绍兴)有限公司内，绍兴市首片 8 英寸晶圆顺利下线。



中芯绍兴项目总投资 58.8 亿元，是绍兴集成电路小镇全产业链发展的关键性项目，投入生产后可实现年产值 45 亿元。中芯国际绍兴 8 英寸产线，规划年产 8 英寸 50 万片和 20 亿颗芯片封装生产线。主要产品包括 MEMS、IGBT、MOSFET、RF 等产品线。

2018 年 3 月，中芯国际绍兴项目落户小镇。78 天后，该项目奠基开工。今年 6 月 19 日，中芯绍兴芯片制造及封装测试生产基地项目举行主体工程结顶仪式。8 月，中芯绍兴项目完成首台工艺设备的进场安装，正式开启投产前的准备阶段。10 月，中芯绍兴完成了首批 151 台(套)生产设备的搬入。11 月，项目通线投片。

(4) 长电科技(绍兴)300 毫米 IC 中道先进封装项目启动

11 月 16 日，电科技(绍兴)300 毫米集成电路中道先进封装项目正式启动，浙江省副省长高兴夫、绍兴市委书记马卫光、市委副书记、市长盛阅春、长电科技 CEO 郑力、华芯投资三部总经理范晓宁、浙江省金融控股董事长章启诚、市人民政府副市长邵全卯、绍兴市越城区委书记金晓明、长电科技顾问赖志明共同开启长电绍兴项目的新篇章。此次长电科技绍兴项目总投资达 80 亿元，将以集成电路晶圆级先进制造技术的应用为目标，为芯片设计和制造提供晶圆级先进封装产品。项目一期规划总面积 230 亩，建成后可形成 12 英寸晶圆级

先进封装 48 万片的年产能。二期规划总面积 150 亩，以高端封装产品为研发和建设方向，打造国际一流水平的先进封装生产线。

2. 杭州寰星电子发布 Wi-Fi、蓝牙、SSD 三款芯片新品

11 月 29 日，杭州寰星电子科技有限公司“芯联万物·睿创未来”主题芯片发布会在杭州富阳成功举办！此次发布会，寰星电子正式发布了高速率连接 AS1000 Wi-Fi 芯片



和低功耗自组网 AS6000 Bluetooth 芯片，并亮相了面向数据存储领域的超大容量 AS9000 SSD 控制器芯片。

此次活动特邀杭州市政府领导、行业专家及众多行业合作伙伴出席，受到了社会各界的广泛关注。富阳区委书记朱党其，富阳区常委丁永刚，富阳经济技术开发区党工委书记、管委会主任许玉钧，浙江省半导体行业协会特别顾问陈光磊等均受邀出席，相关战略生态合作伙伴苏州晶方半导体、贵州木弓贵芯微电子、上海深聪半导体、深圳科诚达股份等出席此次发布会。

富阳区常委丁永刚为本次发布会做开幕致辞，在致辞中对寰星电子芯片产品发布会送上了热烈祝贺，欢迎更多高科技企业能够落户富阳，加速富阳区高科技产业的快速发展，共创辉煌。

浙江省半导体行业协会特别顾问陈光磊做了“乘风破浪潮头立，造芯强芯正当时”的精彩致辞，就浙江省半导体集成电路产业做展望性发言。

寰星电子 CEO 于涛先生分享了公司发展及研发历程，并重磅推出了 Wi-Fi、蓝牙、SSD 主控这三款芯片产品，并就其市场应用做了具体介绍。这三款产品满足了公司在物联网连接领域及数字化时代对于效率和性能的更高要求。

寰星电子 AS1000 Wi-Fi 芯片

寰星电子最新发布的 AS1000 是一款高集成度、低功耗的 WLAN 微控制器 SoC 解决方案，可广泛应用于智能音视频传输、智能家居、消

费类电子、个人健康设备、安防设备、无线网关等领域。

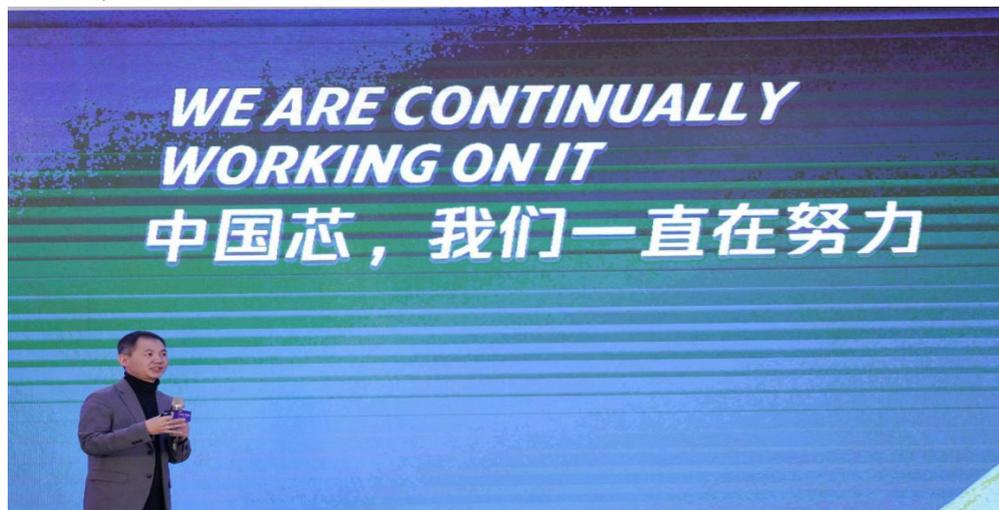
寰星电子 AS6000 蓝牙芯片

据了解，寰星电子此次发布的 AS6000 是一款高集成度，低功耗，高性能，高性价比的蓝牙微控制器 SoC 解决方案，可广泛应用于消费类电子、智能可穿戴、智能家居、智能楼宇、工业照明等物联网领域。

寰星电子 AS9000 SSD 主控芯片

最新亮相的 AS9000 是一款高性能、高兼容性和高稳定性的一款 SSD 固态控制器整体解决方案，其高速读写、多接口、多功能的特性，非常适合于移动硬盘、个人电脑、网络存储、无线数据共享、多种协议共存的物联网 IOT 网关等应用。

此次芯片发布会，杭州寰星电子科技有限公司三款产品的强势推出，将进一步完善公司产品布局。



寰星电子是国内拥有 GNSS、Wi-Fi、Bluetooth、SSD Controller 等核心技术的芯片设计公司，依托自主研发能力及行业积累，为通讯、物联网、消费电子、云计算等行业，提供专用与通用芯片及整体解决方案，致力于成为 IC 设计领域技术先进、服务优质、具有创新性的专业化芯片企业。其相关芯片可广泛应用在消费电子、物联网、人工智能、5G、智能家居、汽车电子、照明、数据存储等众多领域。

3. 第 94 届中国电子展开幕 省半导体协会率团观展

10 月 30 日，第 94 届中国电子展在上海新国际博览中心开幕。浙江省半导体行业协会携杭州地区电子相关行业企业的人员包车前往上海观展。

本届展会以“信息化带动工业化，电子技术促进产业升级”为主题，展览面积 36000 平方米，逾 800 个展位，聚焦展示电子元器件、集成电路、测试测量、电子设备与智能制造、汽车电子、物联网、嵌入式等领域，倾力打造从上游基础电子元器件到下游产品应用端的全产业链阵容，并汇聚数万名买家和专业观众。

4、协会成功推荐江丰电子姚立军董事长入选第十八届省优秀企业家

为表彰和弘扬浙江企业家精神，浙江省企业联合会、浙江省企业家协会开展“第十八届浙江省优秀企业家”评选表彰活动，得到了全省广大企业、企业家的热烈响应。在各市企业联合会、企业家协会及省行业协会推荐的基础上，经考察、评审，确定了 45 名入选名单。

由浙江省半导体行业协会推荐的宁波江丰电子材料股份有限公司姚力军董事长兼首席技术官入选“第十八届浙江省优秀企业家”名单。

5、协会成功推荐晶盛机电产品入选“2019 年浙江省优秀工业产品”

为全面贯彻党的十九大精神，落实“高质量发展”国家战略，打造高端产品与先进制造协同创新的生态系统，全面推进质量变革、效率变革、动力变革，提高浙江工业产品的社会知名度和附加价值，提升产品国际竞争力，更好地打造浙江省优秀工业产品的“金名片”，浙江省工业经济联合会会同全省 63 家省级行业协会和地市“三会”，开展了“2019 年浙江省优秀工业产品”评选活动，经浙江省优秀工业产品评选委员会按照《浙江省优秀工业产品评选办法》规定，进行了严格缜密的初选、专家评审、决选等程序，拟评选出 179 个产品为 2019 年度《浙江省优秀工业产品》。

其中由浙江省半导体行业协会推荐浙江晶盛机电股份有限公司的 TDR 系列单晶硅生长炉入选“2019 年浙江省优秀工业产品”名单。

6、中晶嘉兴年产 480 万片 12 英寸大硅片项目：全部工程 2024 年完成

近日，南湖发布官方微信号发布了中晶(嘉兴)半导体大硅片项目的最新进展。

嘉兴科技城中晶（嘉兴）半导体有限公司目前项目各厂房桩基工程已经完成，拉晶厂房已主体结顶，抛光打磨厂房、综合楼、配套房、公用站房正在建设中。

据企业负责人介绍，截至 2019 年 9 月，已完成固定资产投资 4.66 亿元。预计今年 12 月，项目一期土建工程可全部完成，2020 年 7 月，一期厂房可竣工投入使用，全部工程预计在 2024 年 6 月完成。

2019 年 1 月 19 日，浙江嘉兴南湖区人民政府与上海康峰投资管理有限公司签署投资协议和定向基金协议，年产 480 万片 12 英寸硅片（300mm）项目大硅片项目落户嘉兴科技城。

该项目计划总投资 110 亿元，其中一期投资 60 亿元，固定资产投资超 56 亿元，用地面积 139 亩，计划建设 12 英寸单晶硅片生产线。项目计划于 2021 年 2 月竣工投产，建成后将形成年产 480 万片 12 英寸大硅片产能，预计实现年销售产值达 35 亿元。

6、宁波再添芯动力：康强电子半导体封装材料等三大 IC 项目同日落地

11 月 20 日，主题为“应用驱动、芯创未来”的 2019 中国（宁波）集成电路产业生态论坛在宁波市鄞州区举行。会上，三个集成电路项目落地。

会上，光通信安全芯片项目、康强电子半导体封装材料生产研发基地项目、宁波市芯成伊电子科技有限公司正式签约。

其中，宁波市芯成伊电子科技有限公司是一家集成电路和分立器件、电子模组研发、生产、销售和服务于一体的电子科技企业。

宁波康强电子股份有限公司则是中国最大的集成电路引线框架供应商，也是全国十大集成电路专用材料企业之一。总投资 1.5 亿元的康强电子半导体封装材料项目，将打造全球前列的半导体封装材料生产研发基地，计划于 2019 年底前完成设计与实施方案，2022 年全部达产。

光通信安全芯片项目产品定位于光通信安全芯片和模块研发，将有效推动网络通信安全领域的自主可控发展。

7、“中欣晶圆大硅片项目”竣工投产

近日，位于钱塘新区的中欣晶圆大硅片项目竣工投产，8 英寸产

线具备月产 10 万枚硅片的能力。

该项目竣工投产不仅填补了杭州集成电路产业制造环节的短板，而且为数字经济发展注入强劲支撑。

由日本 Ferrotec 株式会社、杭州大和热磁电子有限公司及上海申和电子有限公司共同投资成立的中芯晶圆，致力于成为国内半导体大尺寸硅片生产的“标杆工厂”。

中芯晶圆副董事长郭建岳介绍，目前产线已经具备月产 8 英寸硅晶圆 10 万枚的能力，为明年实现月产 35 万枚的半导体硅晶圆规模奠定了坚实的基础。“这是国内首座规模最大、技术最成熟并且拥有自主核心技术的可量产 8 英寸半导体大硅片生产线。”他说，目前企业正在进行 12 英寸硅片产线的调试，预计 12 月底将产出 12 英寸硅片。12 英寸生产线将在 2020 年具备月产 10 万枚的产能，2021 年具备月产 20 万枚的产能。

8、博雅鸿图发布首颗数字视网膜系列芯片“鸿芯图腾 GV9531”

近日，在云栖小镇，杭州博雅鸿图视频技术有限公司发布了首颗芯片“鸿芯图腾 GV9531”。

“鸿芯图腾 GV9531”是数字视网膜系列首颗芯片，可以实现自主可控、安全可信的高性价比和高效能比的视频编解码及 AI 计算解决方案，支持多元视频信息流式表达，包括高效的视频编码（AVS2/H.265）、高效的特征编码（CDVS/CDVA）、高效的模型编码（CNN/多核异构），以及边（眼）云（脑）协同机制，包括视觉注意机制、功能/性能（模型和参数）的软件定义、视频与特征联合编码等。

据了解，该芯片具有广泛的用途，可作为智能摄像机、智能物联网网关、AI 服务器、应用系统服务器等设备的计算芯片和集群应用，还能为智慧公安、智能交通、城市大脑等典型应用场景提供高性价比的赋能计算平台，大幅降低计算成本。同时，芯片具备自主标准、自主可控、安全可信等优势，也适用于特种行业等解决方案。

国内资讯

1、晶圆代工双雄争霸汽车市场

外电报导，台积电最新规划搭载 7 纳米的车用半导体解决方案，对手三星也宣布专攻车联网的 8 纳米方案，双方战场将延伸到车用市场；此外，分析认为，由于过往台积电均以领先的工艺大败三星，未来可能再度抢下汽车市场江山，并成为进一步成长的主要动能。

台积电此次与美国电子设计自动化业者 ANSYS，共同推出名为「汽车可靠性指南 2.0」的解决方案，主要结合 ANSYS 的 IP 技术和台积电的 7 纳米先进制程；相较目前台积电采用 16FCC 支援车用芯片。新方案具备更能因应新一代汽车系统的高严谨性和安全要求。

台积电表示，新方案的流程主要纳入电迁移、自体加热和芯片封装产热等热可靠度分析、静电和统计 EM 预算 (SEB) 分析；预期该车用级 7 纳米制程，有望于 2020 年认证。而目前芯片大厂新思和安谋已分别采用台积电的 7 纳米，推出车用级 IP 与处理器。

2、总投资 15 亿元，氮化镓半导体材料项目落户辽宁盘锦

近日，辽宁百思特达半导体科技有限公司投资的氮化镓项目落户辽宁盘锦高新区。

据悉，这个项目计划占地 440 亩，总投资 15 亿元，分 3 期建设，一期投资 3 亿元。项目以氮化镓半导体材料为主，相关配套辅助产业为辅，并在盘锦建立新材料闭环产业园。计划于 11 月前开工建设，2021 年 6 月前竣工投产。

辽宁百思特达半导体科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性高科技企业。公司主要生产销售 LED 全产业链产品。

3、华通投资 25 亿建全球领先手机电路板工厂

近日，华通电脑(重庆)有限公司年产 500 万平方英尺 HDI 电路板二期项目举行奠基仪式。该项目总投资约 25 亿元人民币，将运用当前行业内最先进的设备与技术，致力打造全球手机电路板最先进工厂。项目计划于 2021 年 6 月正式量产。华通电脑(重庆)有限公司位于涪陵新城，一期项目已于 2014 年建设完成并投入生产。因产能需求，企业拟启动二期项目建设，建筑面积约 92000 平方米。

据了解，华通电脑股份有限公司是台湾最早的电路板 (PCB) 专业制造公司，华通电脑(重庆)有限公司是其在大陆的第四家分公

司，主要生产印制电路板 (PCB)、高密度印制电路板 (HDI) 及研发高密度连接电路板技术 (Anylayer) 等，涵盖了电路板的设计、研发、加工、生产，销售等业务。其手机电路板客户包括苹果、华为、OPPO、VIVO、中兴、小米等世界一流电子生产厂商。

4、上达电子柔性集成电路封装基板项目在安徽六安开工

据六安市人民政府发布，10月28日上午，全省贯彻落实“六稳”重大项目10月集中开工暨六安市上达电子柔性集成电路封装基板项目开工动员会在金安经济开发区举行。

安徽省委常委、常务副省长邓向阳代表省委、省政府向此次集中开工的重大项目表示祝贺，向奋战在项目建设一线人员表示亲切慰问。邓向阳指出，此次集中开工把主会场设在六安市上达电子柔性集成电路封装基板项目开工现场，充分体现了省委、省政府对承接产业转移、促进经济转型升级的高度重视，也充分体现了省委、省政府对革命老区坚决打赢脱贫攻坚战的坚定信心和决心。

国际资讯

1、三星正式发布 Exynos 990 旗舰处理器

据 sammobile 报道，三星公司在加利福尼亚州圣何塞举行的 2019 年“三星技术活动”上正式推出了 Exynos990 旗舰处理器。三星表示 Exynos990 处理器和 ExynosModem5123 芯片将于今年年底进入批量生产。

三星称这是基于 7nmEUV 工艺的旗舰移动处理器。Exynos990 采用双核 NPU，算力可达 10TOPs。还支持 120Hz 刷新率、LPDDR5 (2750MHz)、108MP 传感器等。三星 Exynos990 处理器采用新的 5G 调制解调器，为 ExynosModem5123，支持所有的网络技术 (5G 双模、兼容 2G-4G)。官方称在 5G 上可以提供 7.35Gbps 的最大下载速度，在 4G 上提供 3.0Gbps 的最大下载速度。

2、美开发出新型可拉伸、可降解半导体材料

美国斯坦福大学研究人员近日在美国化学学会期刊《ACS 核心科学》上发表研究报告称，他们开发出一种可拉伸、可完全降解，并能在应变时保持稳定电气性能的半导体材料。研究人员称，这一同时具

有 3 种不同属性的新材料有望在医疗、环境监测、信息安全等领域得到广泛应用。

在新研究中，斯坦福大学研究人员将一种可降解的橡胶状有机聚合物和一种可酸降解的半导体聚合物混合，组装成半导体纳米纤维。由这些纤维制成的薄膜可以拉伸到其正常长度的两倍而不会破裂或损害其电气性能。当置于弱酸中时，这种新材料会在 10 天之内完全降解。该材料对人类细胞无毒，但其在人体内的降解时间要更长一些。

研究人员表示，这是他们首次研发出同时具有半导体性、可拉伸性和完全可降解性这 3 种不同属性的新材料，该材料具有不受应变影响的机械和电气性能，可用于开发各种多功能电子设备，有望在医疗、环境监测、信息安全等领域大显身手。例如在医疗领域，可拉伸、有弹性的生物医学设备可以与人体器官紧密结合，不会因机械不匹配而引起炎症反应；而可完全降解的能力又能使病人能免除二次手术的烦恼，在保证治疗效果的同时也会大大减轻病人的痛苦。

3、钙钛矿 LED 发光效率提高 4 倍

日本九州大学、长春应用化学研究所、京都大学化学研究所、中国科学院、法国索邦大学及法国国家科学研究中心—斯特拉斯堡大学合作，通过选用合适的有机材料，成功地将准二维钙钛矿 LED 的发光效率提高到原来的 4 倍左右。

钙钛矿薄膜制作简单，而且能实现色纯度较高的发光。因此，钙钛矿 LED 有望用于低成本、高色纯度的新一代显示器。采用此次的方法，可以大幅提高钙钛矿 LED 的发光效率，将给显示器行业带来巨大的冲击。另外，利用该方法还有望提高钙钛矿的激光振荡特性，能为医疗和通信领域作贡献。

业内看点：

1、严晓浪：集成电路产业未来 5 年或将带动超千亿元整机产值

11 月 20 日上午举行的 2019 中国（宁波）集成电路产业生态论坛上，中国半导体行业协会专家委员会主任严晓浪带来主题分享：《不忘初心 牢记使命 我国集成电路产业发展 20 年》。

严晓浪先后担任国家示范性微电子学院建设专家组组长、专用集成电路与系统国家重点实验室主任等职务，研究领域涉及集成电路物理设计和逻辑设计方法等，相应成果曾获多项国家级和省部级奖励。

以下为严晓浪演讲核心要点：

在我们国家中长期的科学技术发展规划中，信息领域有三个重大专项，包括核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品（核、高、基）；极大规模集成电路制造装备和成套工艺；下一代无线移动通信技术，目前的技术重点是 5G。

近几年，我国核心芯片主要依赖进口，包括半导体存储器，国产芯片占有率微乎其微。2014 年，最高领导层提出，将半导体芯片工业作为战略性产业抓住不放、实现跨越。同年，《国家集成电路产业发展推进纲要》出台，《纲要》指出，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。

发展集成电路产业的核心之一，是产业人才的培育。目前，我国集成电路产业人才总量不足、领军人才缺乏、人才结构不合理，远不能满足产业对人才的需求，迫切需要培养一大批高素质工程人才。在《国家集成电路产业发展推进纲要》出台之后，教育部快速跟进，建设示范性微电子学院，国家政策也不断出台关于集成电路产业人才培养的有利政策。

“芯火”创新行动计划

2017 年，工信部发布了“芯火”创新行动计划，这个计划，是实现我国集成电路设计业跨越发展的重要计划，该计划聚焦“核心技术自主创新”这一主题，要求实现“提升产品自给率，构建产业生态体系”两大目标。

具体来讲，这一计划力争通过 3 年时间，逐步建立 5-10 家芯火创新基地，结合各基地特色优势，打造 10 类以上芯片创新平台，累计超过万人参与到创新创业中；围绕智能硬件、云计算、工业互联网、传感器等具体应用领域，形成具有中国特色的“芯片—软件—整机—系统—信息服务”的产业生态体系；力争每年培育 15 到 20 家优秀创

业团队（第一年除外），五年内预计形成超百亿元的芯片产值，带动形成超千亿元整机产值。

总结来讲，“芯火”创新行动计划是一个技术创新服务平台、自主知识产权推广平台、产学研用产业链建设平台、人才培养与协同创新平台，很大程度上可以弥补我国高新技术产业成果转化率低、知识产权保护不力的状况。因此，建设以国家芯火创新行动平台为主框架，以高等学校、科研院所、专业机构和创新企业协同支撑的国家集成电路设计产业技术创新体系十分必要。

2、宁波集成电路产业如何突围？浙江省半导体行业协会代秘书长丁勇如是说

中国集成电路的人才缺口大概有 30 万，我们每年培养的学生只有 3 万人，缺口很大。如果宁波要发展，最大的短板就是人才，当地的高校能够和企业协同发展培育人才，包括宁波大学、宁波理工大学、宁波诺丁汉大学和企业形成协同育人，产研一体的格局，是比较利于宁波集成电路产业发展的。企业在和高校协同的过程中，要留住好的人才，提高人才待遇，目光长远，为整个产业发展培养更多人才。

3、格芯：摩尔定律不会死去，但是意义已经发生变化

在 10 月 24 日举行的格芯 2019 年技术大会上，格芯中国区总裁及亚洲业务发展负责人 Americo Lemos 表示，近年来格芯不断在进行战略转型和业务的挑战，虽然放弃了一些市场和业务，但是格芯的战略也愈加清晰。

随着物联网等新兴技术的快速发展，半导体在生活中所扮演的角色越来越重要，无论是日常所使用的设备还是基础设备，电子设备的占比越来越高，而这一趋势将会为半导体产业将迎来巨大的增长机遇。

格芯财务、战略和业务转型部执行副总裁 Tim Breen 在演讲中指出，在这一背景之下，全球的供应链和原本的合作伙伴关系都迎来了剧烈的变化，由于供应链和产品迎来的变化与挑战，整个产业也在剧烈的变化。

数据显示，2018 年全球 GDP 总额为 85 万亿美元，其中 2 万亿美元为电子行业，4750 亿美元为半导体行业，630 亿美元为晶圆代工产

业。而晶圆代工产业绝大多数由全球五大晶圆代工厂所贡献。

而正如之前所说，这个产业正在发生巨变和增长，TimBreen认为，在物联网，5G 的技术的推动下，晶圆代工产业将迎来巨大的发展机遇。

正是看到了这一机遇，格芯在近年来进行了一系列的战略挑战。因为在TimBreen看来，未来所要讨论的并不是摩尔定律有没有效，而是能持续多长时间。

“在我看来，摩尔定律并不会死去，只是其意义发生了变化。以往的摩尔定律聚焦于如何让芯片变得越来越小，而未来，摩尔定律将聚焦于如何让芯片变得越来越好。”TimBreen强调。而想要实现这一目标，除了进行制程的微缩之外，还存在很多方法。

格芯的战略转型也是基于这一想法，AmericoLemos表示，格芯致力于成为与众不同的晶圆厂，为客户提供更适合其产品的解决方案，帮助客户创造更好的产品。

对此，TimBreen也表示，格芯的目标不是如何保证摩尔定律继续持续下去，而是让芯片更好的适用于产品，更好的为产品服务。格芯战略的转变也在于，如何为客户提供更好的定制化的产品。

“格芯已经走过了十年的时间，未来将会迎来更大的发展机遇，也将会继续追逐行业的发展趋势。”对此，AmericoLemos表示，在中国，格芯将聚焦于物联网，5G 和云计算三大领域。

编辑部: 浙江省半导体行业协会秘书处 网址: www.zjsia.org.cn
地址: 杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼四楼B4068 电话: 88409702
手机: 17300929113 邮箱: 854852842@qq.com QQ 群: 515678834